

IPC ERFA-møde, torsdag den 13. juni 2019

Afholdes hos HYTEK, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Dagsorden:

- 10:00** **Velkomst** v/Jens Taudal Andersen, HYTEK
- 10:05** **Nyt fra IPC** v/Jens Taudal Andersen, HYTEK
- Gennemgang af de nyeste udgivne IPC-standarder
- 10:15** **Ultralydssvejsning af plastdele** v/Jens Weensgaard, samt Peter Juul Andrés, Rinco Ultrasonics Danmark A/S
- Intro til Rinco som organisation; think global – act local
 - Intro til US svejsning – kort og præcist
 - Intro til US svejsning i elektronikindustrien
 - Opmærksomhedspunkter, når der svejdes i elektronik industrien
 - Muligheder – hvorfor US svejsning – fordele
 - Videoeksempler / billeder
 - Referencer
- 11:15** **Stackup design for high speed PCB's** v/Neil Chamberlain, Polar Instruments
- Controlled impedance and insertion loss
 - Boundary element simulation
 - Material influences
 - Copper influences
 - Stackup specification
- 12:15** **Frokost / lunch**
- 13:15** **Aging mechanisms and solutions to store components for long term** v/Nicole Dorsheimer, HTV halbleiter-test & vertriebs
- Obsolescence
 - Aging processes and risks
 - Our solution to store electronic components for long term: TAB (Thermal-Absorptive-Gas Barrier)
 - Comparison of storage methods
- 14:15** **Eventuelt**